U3-3040LE-C-HQ Rev.1.2 (AB03436)

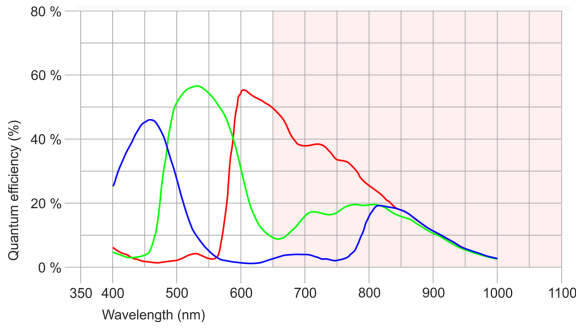
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	1.6 MP
有効画素数	1.58 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1456 x 1088 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2.9''
撮像面積	4.996 mm x 3.747 mm
光学センサーの対角	6.25 mm 1/2.9″
画素サイズ	3.45 µm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX273LQR-C
ゲイン (マスター/RGB)	25.4x/16x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	2 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ビニング水平	-
ビニング垂直	-
ビニング手法	水平: - / 垂直: -
ビニング係数	-
デシメーション(サブサンプリング)水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)手法	M/C 自動



T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3040LE-C-HQ Rev.1.2 (AB03436)

モデル

フレームレートフリーランモード	235 fps
フレームレートトリガー（連続）	244 fps
フレームレートトリガー（最大）	244 fps
露出時間（最小～最大）	0.022 ms - 2000 ms
長時間露出（最大）	30606 ms
消費電力	0.8 W - 1.8 W
画像メモリ	-

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 80 ° C / -4 ° F - 176 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB Type-C
I/O コネクター	-
電源	USB ケーブル

設計

レンズマウント	CS- / C-マウントレンズ
保護構造	IP30
外形寸法	47.0 mm x 46.0 mm x 23.9 mm
重量	38 g
ハウジング素材	プラスチック

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	-
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	-
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	-
画像調整	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3040LE-C-HQ Rev.1.2 (AB03436)

統合画像処理	Pixel formats	BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
	Binning (FPGA)	–
	Binning (Sensor)	
その他	Chunks	–
	Sequencer	–
	Events	–
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.20

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp